北京晶亦精微科技股份有限公司2024校园招聘简章

**一、公司简介**

北京晶亦精微科技股份有限公司（以下简称公司）是由北京烁科精微电子装备有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，是中国电科（CETC）将CMP*（全称Chemical Mechanical Polishing，即化学机械抛光，是半导体晶片表面加工的关键技术之一）*业务进行科技成果转化，构建多元化股权结构，成立于2019年9月的国家级高新技术企业，注册地为北京市经济技术开发区，注册资本16646.135万元。

公司围绕中国电子科技集团有限公司 “国内卓越、世界一流、大国重器”的战略目标和赋予中电科电子装备集团有限公司“发展国产装备，铸就国芯基石”的使命，以实施“双百行动”为契机，聚焦集成电路核心装备CMP核心主业，围绕产业化和市场化进程中亟待突破的技术和经营短板，不断推进CMP设备研发与产业化进程，不断加强能力建设、构建经营发展体系，夯实核心竞争力，不断激发员工的积极性和创造性，为股东创造更大价值，为员工创造更加幸福而有尊严的生活！

**二、招聘岗位**

**（一）机械设计工程师 10名**

岗位职责：

1.负责产品机械结构、关键零部件设计，材料选用，机械结构仿真模拟；

2.与电气工程师配合完成产品电气设计，负责客户现场设备问题排查分析，优化改进。

岗位要求：

1.本科及以上学历，机械设计制造相关专业；

2.熟练使用机械绘图软件，如solidworks等，熟练使用仿真软件，如Ansys等；

3.熟悉常用自动化元件种类、使用方法，能独立选型。

**（二）研发工程师 5名**

岗位职责：

1.新产品机械模块详细设计及计算，输出3D模型和2D图，输出机械设计方案说明，方案仿真分析；

2.产品测试验证方案设计，数据整理，物料投产与机械零件外协过程中的技术沟通和问题解决。

岗位要求:

1.本科及以上学历，机械设计、机械制造、机电一体化等相关专业毕业；

2.有良好的机械设计基础知识， 熟练使用 Solidworks等绘图工具设计软件；具备一定的项目进度管控能力。

**(三)软件开发工程师（自动化控制岗/人工智能岗）5名**

岗位职责：

1. 软件功能的需求、设计、开发、测试等环节文档编写，完成软件设计、开发调试及部分测试等工作；

2.完成实验室设备的软件安装及部分测试工作，完成客户现场的技术需求获取和支持工作。

岗位要求：

1. 本科及以上学历，计算机软件、自动化、控制理论和控制工程、计算机技术等相关专业；

2. 自动化控制岗要求熟练运用Visual Studio C++/C#语言，熟悉MFC编程，熟悉滤波算法、自动化控制、mysql者优先；人工智能岗要求研究方向为人工智能、自然语言处理、图像文本识别、模式识别等，熟悉机器学习，深度学习算法。

**（四）电气/电子工程师 10名**

岗位职责：

1.负责半导体设备的电气方案设计，可行性验证；负责电气器件选型，BOM、电气图纸等文件编制；

2.负责PLC控制程序编程及调试；负责运动控制设计及伺服系统的设计调试。

岗位要求：

1.本科及以上学历；

2.电气工程师要求自动化、测控技术与仪器、机电一体化、电气工程及其自动化、控制科学与工程等相关专业；电子工程师要求电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、测控技术与仪器等相关专业。

**（五）工艺工程师 10名**

岗位职责：

1.满足客户需求，提供工艺开发和现有工艺技术改善；

2.总结评估测试数据并能以此决定适合的工艺参数；

3.负责专业的工艺开发、研究、评估，提供客户端现场设备及系统技术支持。

岗位要求：

1.学历要求统招全日制本科以上，物理、化学、材料科学、机械相关专业；

2.在校期间研究方向涉及半导体、集成电路领域或有相关实习经历者优先。

**（六）售后服务工程师 10名**

岗位职责：

1.CMP设备出厂前调试、客户现场装机和维护。

岗位要求：

1.全日制本科学历，机械、电气、自动化等相关专业毕业；

2. 有较强的学习能力、沟通能力，做事细致有耐心，可接受长期出差。

**三、薪酬福利：**

薪酬结构：基本工资+绩效+岗位津贴。具体薪酬一人议。

福利情况：带薪年假、年底双薪、生日福利、节日福利、员工宿舍、六险一金、定期调薪、定期体检、团建活动。

**四、招聘流程**

投递简历、简历筛选、人力面试、技术面试、发放offer

**五、投递方式：**

1.智联招聘、猎聘搜索“晶亦精微”

2.邮箱投递：haoyu.wang@gegvs.cn yue.tong@gegvs.cn简历请命名为“岗位+姓名+学校+学历+专业”